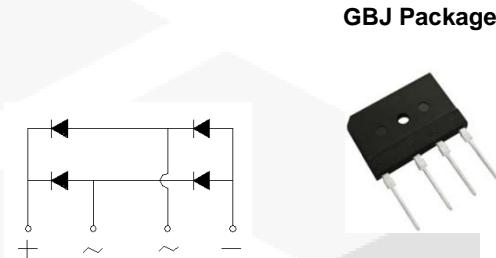


Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier

V_{RRM} = 100 V - 400 V
I_O = 30 A

Features

- Epoxy Resin material compliant with 94V-0 standards of UL Material Flammability Provisions
- Compliant with RoHS Provisions
- Single in-line DIP package, compact size
- Low forward voltage, high forward current
- High surge current capability
- Types from 100 V to 400 V V_{RRM}
- Small size, high heat-conducting performance
- Thermal welding performance: 260 °C/10 s
- Weight: 7.25 g (0.25 Oz)
- Not ESD Sensitive



Maximum ratings at T_A = 25 °C (ambient temperature), unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	GBJ30B	GBJ30D	GBJ30G	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}		100	200	400	V
DC blocking voltage	V _{DC}		100	200	400	
Operating temperature	T _j		-50 to 150	-50 to 150	-50 to 150	°C
Storage temperature	T _{stg}		-50 to 150	-50 to 150	-50 to 150	°C

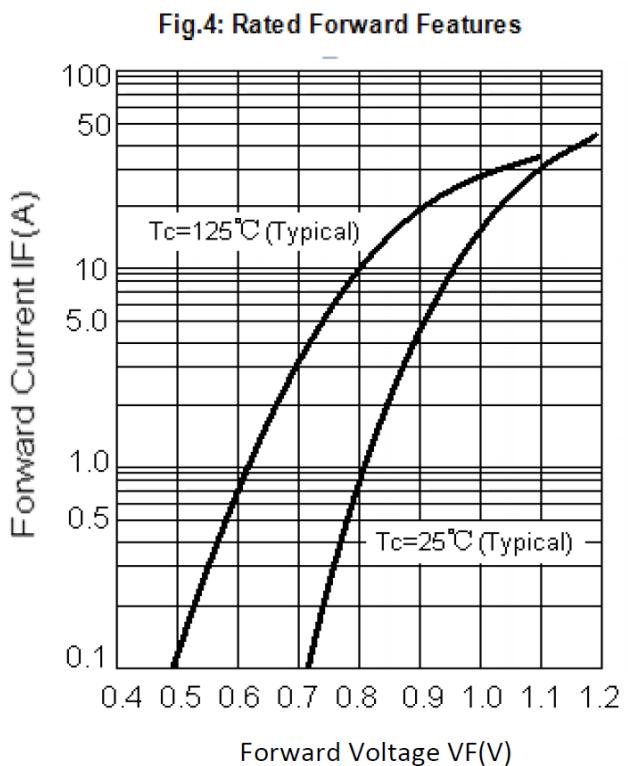
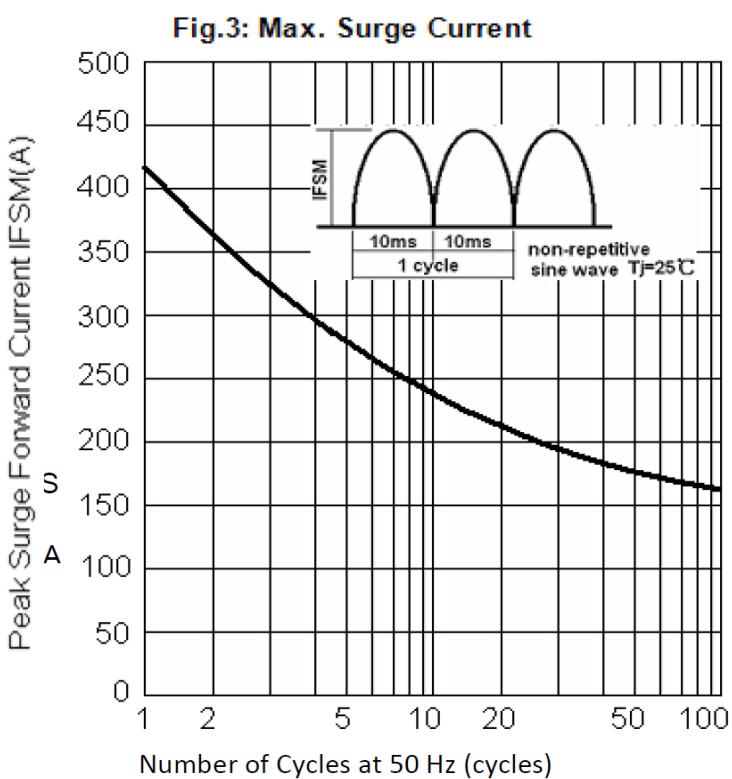
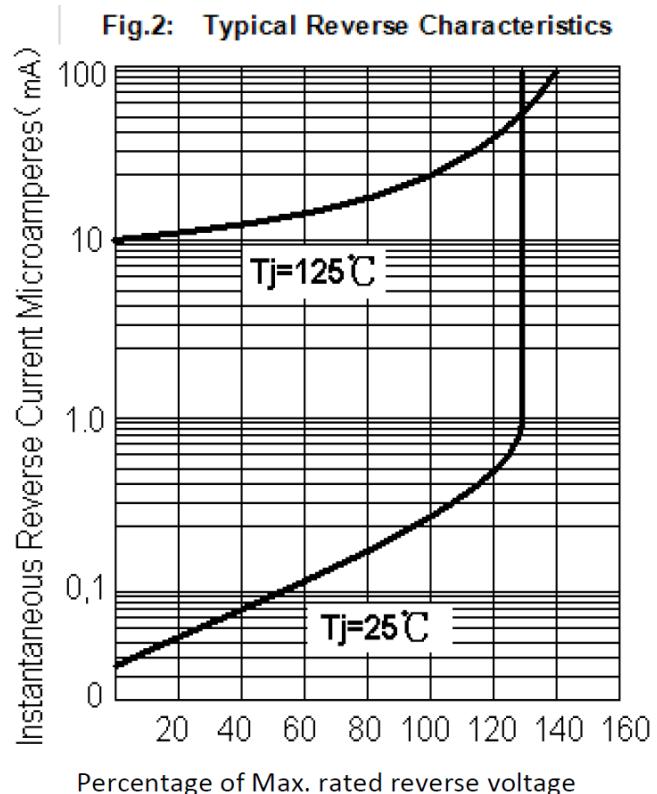
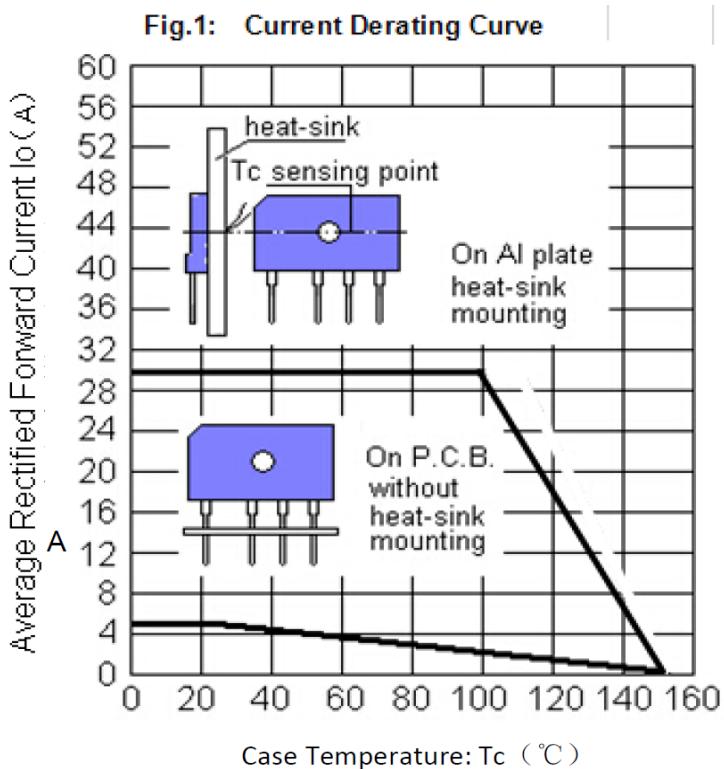
Electrical characteristics at T_A = 25 °C, unless otherwise specified

Resistive load, single phase, half sine wave, 60 Hz.

For capacitive load derate current by 20%.

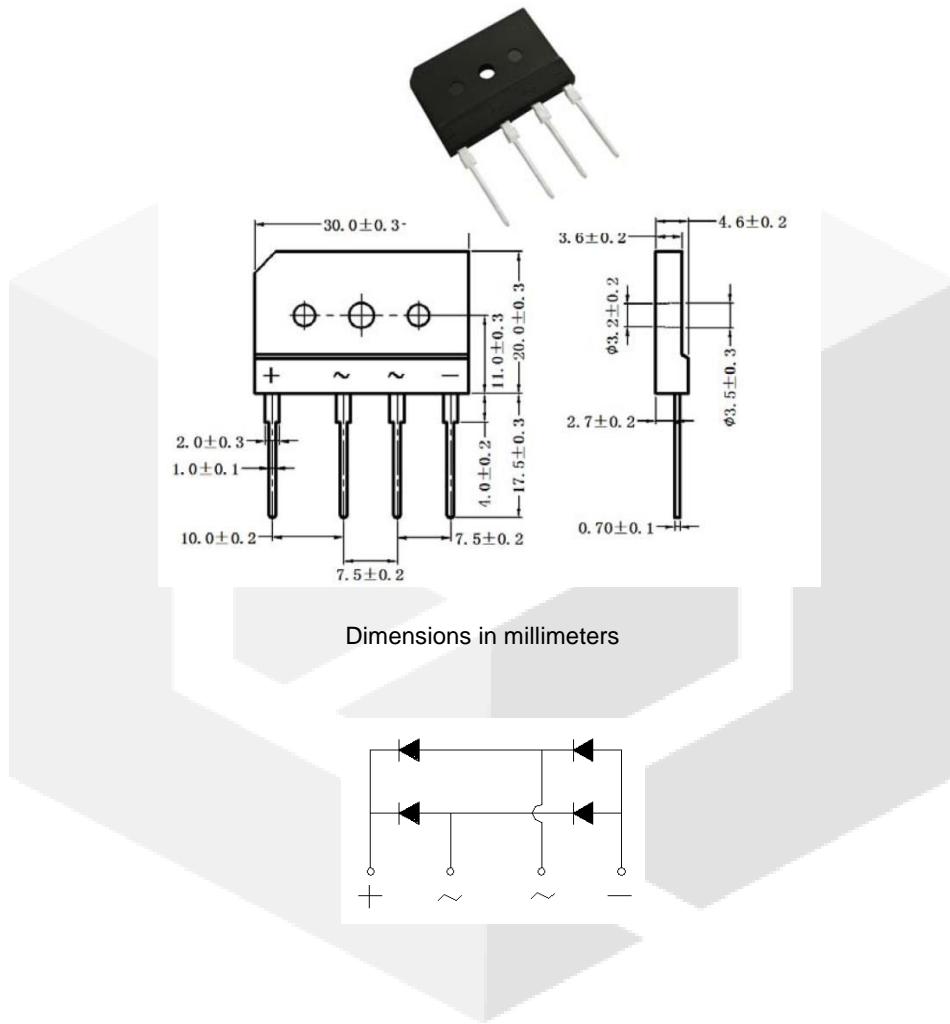
Parameter	Symbol	Conditions	GBJ30B	GBJ30D	GBJ30G	Unit
Maximum average forward rectified current	I _O	T _C = 98 °C T _A = 25 °C	30 ⁽¹⁾ 5.2 ⁽²⁾	30 ⁽¹⁾ 5.2 ⁽²⁾	30 ⁽¹⁾ 5.2 ⁽²⁾	A
Maximum forward surge current	I _{FSM}	8.3 ms pulse width, single pulse sine-wave, rated load, T _j = 25 °C	420	420	420	A
Maximum forward voltage	V _F	I _F = 15 A	1.05	1.05	1.05	V
Max. reverse current leakage at rated DC blocking voltage	I _R	T _A = 25 °C T _A = 125 °C	5 500	5 500	5 500	µA
Insulation strength (Lead wire to case)	V _{dis}	AC Voltage: 1 minute, current leakage < 1 mA	2.5	2.5	2.5	kV
Fusing feature	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, T _j =25 °C	350	350	350	A ² s
Thermal resistance	R _{θJA} R _{θJC}	without heatsink with stated size heatsink	22 ⁽²⁾ 1.0 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ 1.0 ⁽¹⁾	22 ⁽²⁾ 1.0 ⁽¹⁾	°C/W
Mounting torque	T _{OR}		1.0 (0.8 Nm is recommended)			Nm

Remarks: (1) Install on PCB with stated size heat sink. In order to reach excellent heat dissipation performance, please coat thermal conductive silica gel in moderation, use M3 screw to screw up. Recommended heatsink size: 15.2*15.2*12.8 cm.
(2) Install on PCB without heatsink.



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[GBJ30B](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331